

日月光一〇五年度第四季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 106 年 1 月 26 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇五年度第四季及全年獲利報告，本公司一〇五年第四季之合併營業收入較一〇五年第三季成長 6%，較一〇四年同期成長 2%，為新台幣 77,128 百萬元。茲將日月光一〇五年度第四季單季及全年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第四季	105 年度 第三季	104 年度 第四季	105 年度 全年度	104 年度 全年度
營業收入淨額	77,128	72,784	75,548	274,884	283,302
營業毛利	15,377	14,113	13,269	53,194	50,135
營業淨利（淨損）	8,129	7,438	6,801	26,704	24,884
稅前淨利（淨損）	9,680	6,875	6,290	28,052	25,006
所得稅利益（費用）	(1,274)	(976)	(1,259)	(5,091)	(4,839)
非控制權益	(430)	(393)	(322)	(1,269)	(970)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,976	5,506	4,708	21,692	19,197
基本每股盈餘(新台幣元)	1.04	0.72	0.62	2.83	2.51
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.86	0.64	0.60	2.35	2.41

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第四季	105 年度 第三季	104 年度 第四季	105 年度 全年度	104 年度 全年度
營業收入淨額	43,463	43,006	38,406	160,516	154,544
營業毛利	11,647	10,969	9,978	40,009	40,128
營業淨利（淨損）	6,372	6,193	5,313	20,744	21,604
稅前淨利（淨損）	9,058	6,319	5,858	25,492	23,750
所得稅利益（費用）	(967)	(719)	(1,099)	(3,481)	(4,361)
非控制權益	(115)	(94)	(51)	(319)	(192)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,976	5,506	4,708	21,692	19,197

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	53
電腦	10
汽車, 消費性電子及其它	37
前十大客戶佔營收比重	50

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	32
IC Wirebonding	57
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	87 百萬美元
打線機台數	15,897 台

測試業務產品組合	%
後段測試	77
晶圓測試	20
前段測試	3
測試資本支出金額	30 百萬美元
測試機台數	3,739 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	53
電腦	14
消費性電子	20
工業用	7
汽車電子	5
其它	1
前十大客戶佔營收比重	91
EMS 資本支出金額	6 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2017 年第一季的業績展望如下：

- 半導體封測事業第一季生意量將接近去年第二季水準
- 半導體封測事業第一季毛利率將與去年上半年水準相仿
- 電子代工服務第一季生意量與毛利率皆將與去年季平均相仿